

論文募集

日本珐瑯工業会は現在、2021年5月に京都で開催される第25回国際ほうろう会議の論文(議題は以下参照)を募集しています。このE-mailは論文についての多くの情報を掲載しています。

最初にご提出頂く論文のタイトル・執筆者・概要(会議実行委員会による選考の対象になる)、最終レポートおよびPOWER POINTプレゼンテーションの提出期限についてお伝えします。提出期限を過ぎると受付不可であることをご留意下さい。

会議のトピックとテーマ

1. Substrates for enameling (ほうろう用素地)
2. Novel metal fabrication methods (新金属加工方法)
3. Pretreatment and metal preparation (前処理)
4. New types of vitreous enamels (新ほうろう釉薬)
5. Nanotechnologies in enamel coatings (ほうろうコーティングにおけるナノテクノロジー)
6. Application technologies and processes (施釉技術と加工)
7. Process control equipment (加工コントロール装置)
8. Furnaces and firing (焼成炉と焼成)
9. VE training for employees (従業員向けほうろうトレーニング)
10. Sustainability and energy savings (持続可能性と省エネ)
11. Government regulations and environmental compliance (法規制と環境法令遵守)
12. Product testing, measurement and characterization (製品試験、測定および特性評価)
13. New products, markets and applications (新製品、新市場および新用途)
14. Enamels in architecture, graphic arts and design (建築、グラフィックアートおよびデザインにおけるほうろう)

提出期限および重要な期日

タイトル・執筆者および概要の提出期限 -2020年3月31日

採用通知 -2020年5月31日

最終レポート提出期限 -2020年11月1日

最終POWER POINTスライド提出期限 -2021年1月31日

タイトル・執筆者および概要の提出

第25回国際ほうろう会議の実行委員会で選考を行うために、2020年3月31日の締切日までに、論文のタイトル・執筆者(複数含む)および100-200文字の概要を提出して下さい。

本メールに添付しております、「Speaker Reply Form」に英語でご記入の上、日本珐瑯工業会のメールアドレスへお送り下さい。

(日本珐瑯工業会メールアドレス: info_ieicongress@jea2021kyoto.jp)

また、“Speaker Reply Form”は日本珪瑯工業会の HP にも掲載する予定です。

(HP: <http://www.horo.or.jp/>)

最終レポート

会議論文集に掲載するために、全ての文書を 2020 年 11 月 1 日までに提出して下さい。

- ・全て英語で、研究の目的、方法、結果を明確に記述すること。所見や備考が最後に含まれても良い。強調されるべき内容は研究結果である。参考文献のリストを記載すること。
- ・提出される執筆文書の拡張子は.doc もしくは.docx で、日本珪瑯工業会のメールアドレス宛に提出する。(日本珪瑯工業会メールアドレス: info_ieicongress@jea2021kyoto.jp)
- ・次のようにファイル名を作成：執筆者の姓.拡張子 (例：Smith doc./Smith docx.)
- ・論文は最長で A4 用紙 6 枚 (図、表や参照事項含む)

質問及びコメントがありましたら、日本珪瑯工業会のメールアドレスまでお問い合わせ下さい。

Speaker Reply Form

25th IEI Congress

31 May- 1June, 2021 at Kyoto International Conference Center

Please complete and send this form to Japan Enamel Association

Email: info_ieicongress@jea2021kyoto.jp

Full Name of Speaker :

Company :

Phone :

E-mail :

Title of Paper :

Abstract : Please provide your 100-200 word abstract below.